



(19)中華民國智慧財產局

(12)設計說明書公告本

(11)證書號數：TW D230199 S

(45)公告日：中華民國 113 (2024) 年 03 月 01 日

(21)申請案號：111300807

(22)申請日：中華民國 111 (2022) 年 02 月 18 日

(51)LOC.(13)Cl.：13-99

(30)優先權：2021/08/27 日本

2021-018468

(71)申請人：日商國際電氣股份有限公司 (日本) KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION (JP)
日本

(72)設計人：岡嶋優作 OKAJIMA, YUSAKU (JP)

(74)代理人：林志剛

(56)參考文獻：

TW D213399

審查人員：朱哲慶

圖式數：9 共 5 頁

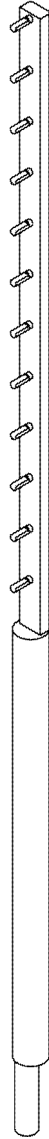
(54)名稱

半導體製造裝置用基板支承具

代表圖：

D230199

TW D230199 S



【立體圖】



公告本

D230199

【設計說明書】

【中文設計名稱】 半導體製造裝置用基板支承具

【物品用途】

【0001】 本設計的物品是半導體製造裝置用基板支承具，是在用以處理複數個晶圓之基板處理裝置中，在處理室內以包圍晶圓基板的方式設置有複數個本物品，並將各晶圓基板載置於插銷上。

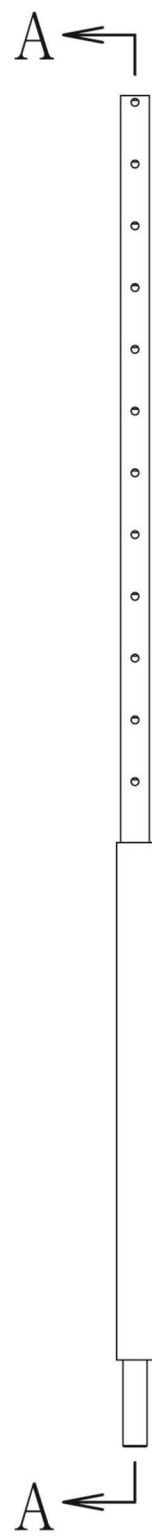
【設計說明】

(無)

【設計圖式】
(指定代表圖)



【立體圖】



【前視圖】



【後視圖】



【俯視圖】



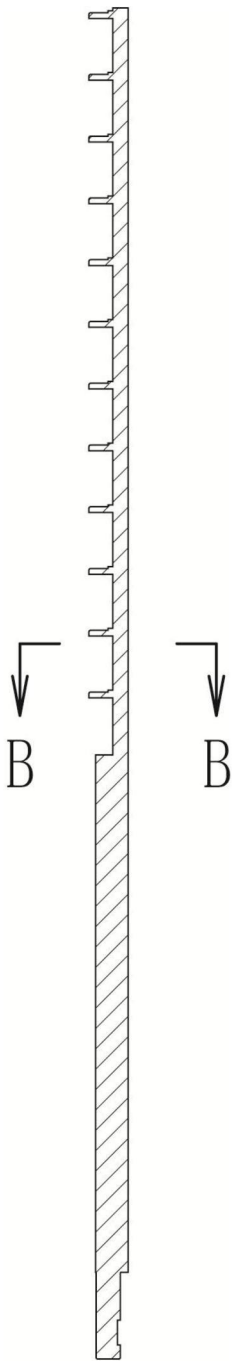
【 仰 視 圖 】



【 左 側 視 圖 】



【 右 側 視 圖 】



【 A-A剖面圖 】



【 B-B放大圖 】